

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中邮证券—吴文吉、万玮 建信理财现金管理投资部—张婧 大家资产—徐博 景顺长城—研究部 进门财经—田自威 国信证券—叶子 华夏基金—谢小龙 民生加银—孙金成 大摩—李子扬 广州金控资产管理有限公司—黄勇 汇丰前海—何方 瑞士信贷—曾昭连 JP摩根—JimmyHuang 野村国际—滕喆安 金翼私募基金管理（珠海横琴）有限公司—罗浩峰 南方天辰（北京）投资管理有限公司—王然 志开投资—王浩然 希瓦资产—薛妍莹 兴业基金管理有限公司—高圣 安信证券股份有限公司—李笑颜 华泰资产管理有限公司—郑金镇 中移资本控股有限责任公司—王翔 财通证券股份有限公司（自营）—张书琪 苏州高新私募基金管理有限公司—高俊 圆信永丰基金管理有限公司—田玉铎 联储润达股权投资管理有限公司—徐汀 中信保诚基金管理有限公司—郑弼禹 长城财富保险资产管理股份有限公司—杨海达 东北证券—尚靖 博时基金管理有限公司—吴兴喆 嘉实基金管理有限公司—谢泽林 交银施罗德基金管理有限公司—梁简泓 汇添富基金管理股份有限公司—李泽昱

	中国人寿资产管理有限公司—张帆 广东正圆私募基金管理有限公司—戴旅京 上海聚鸣投资管理有限公司—惠博闻 浦银安盛基金管理有限公司—高翔 宏利基金管理有限公司—崔梦阳 明亚基金管理有限责任公司—王宁山 九泰基金管理有限公司—洪江根 中信建投证券股份有限公司—徐博、刘岚 东吴基金管理有限公司—张浩佳 百年人寿保险股份有限公司—王溢 杭州正鑫私募基金管理有限公司—常宾 上海万吨资产管理有限公司—蔡文 中邮创业基金管理股份有限公司—汪显森 江苏第五公理投资管理有限公司—郭雷雨、陈乐天 上海汐泰投资管理有限公司—苏莹 华夏未来资本管理有限公司—丁鑫 青岛星元投资管理有限公司—陈旻 北京和聚私募基金管理有限公司—郑颖 中国太平洋保险（集团）股份有限公司—沈维 兴银理财有限责任公司—江耀堃 东方证券股份有限公司—曹伏颀 敦和资产管理有限公司—叶滢 摩根基金管理（中国）有限公司—陈思郁 中泰证券—游凡 平安理财—潘俊伊 易米基金—石文琪 中邮人寿保险股份有限公司—张晋 海通资管—童胜 招商电子—谌薇 嘉实基金管理有限公司—马丹 天弘基金管理有限公司—洪明华 景顺长城—路演 光大永明—沈繁呈 鼎和保险—赵远飞 金鹰基金—田啸 凯石投研—吴蔽野 泰信基金管理有限公司—黄睿东 进门财经有限公司—李思聪 江苏捷捷微电子股份有限公司—张总 富荣基金管理有限公司—毛运宏 太平洋保险资产—沈维 宁波银行理财子公司—韦婉 上海正心谷投资管理有限公司—常晟 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—钟仕捷 北京宏道投资管理有限公司—段然 山西证券—邬敬业
--	--

	合远投资—陈梦笔 华安财保资产—胡哲 沅谊—江昕 北京和聚私募基金管理有限公司—邱颖 朴易投资—尚志强 深圳市平石资产管理有限公司—廖宗怡 赋格投资—陈派卿 南京上德投资管理有限责任公司—吴海娟 国金电子—戴宗廷 雅策—王亿洲 中信资管—罗舜芝 固禾—文雅 华创自营—黄子辰
会议时间	2023 年 10 月 27 日 10:00—10:30（中邮证券） 2023 年 10 月 27 日 13:30—14:00（东北证券） 2023 年 10 月 27 日 15:30—16:20（中泰证券） 2023 年 10 月 28 日 14:00—14:30（国金电子）
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任、证券事务代表：沈志鹏先生，公司证券事务与投资者关系管理专员：秦境凤女士、虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2023年三季度营收情况。 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶

闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，目前，芯片（8英寸、12英寸）部分为委外流片，部分器件封测代工。

2023年前三季度，在客户端的支持与关心下，在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入14.26亿元，较上年同期增加11.02%；第三季度实现营业收入5.25亿元，较上年同期增加17.98%。第三季度报告期内，归属于上市公司股东的净利润4,646.9万元，比上年同期增减-42.81%；年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，年初至报告期末比上年同期增减-51.44%。公司总资产本报告期末78.06亿元，比上年度末增加2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末36.79亿元，比上年度末增加2.76%。

二、主要交流问题

1、公司2023年前三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收及毛利率情况？

年初至报告期末，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入3.18亿，毛利率为48.80%，较上一年度同比增加11.57%，占公司2023年前三季度主营业务收入22.50%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入5.19亿，毛利率为37.15%，较上一年度同比增加20.05%，占公司2023年前三季度主营业务收入36.72%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入5.76亿，毛利率为23.02%，较上一年度同比增加6.54%，占公司2023年前三季度主营业务收入40.78%。

2、公司2023年第三季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？

公司2023年第三季度，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.17亿，较上一季度环比增减-6.50%，较上一年度同比增加24.10%，占公司2023年第三季度主营业务收入22.48%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入2.01亿，营业收入较上一季度环比增加8.72%，较上一年度同比增加34.03%，占公司2023年第三季度主营业务收入38.75%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入2.01亿，较上一季度环比增加10.50%，较上一年度同比增加4.21%，占公司2023年第三季度主营业务收入38.77%。

3、请问公司南通“高端功率半导体器件产业化项目”产能如何，是否达到盈亏平衡？

答：公司“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号，南通“高端功率半导体器件产业化项目”（一期）基础设施及配套等建设已完成，二期部分设备正在逐步投入。一期项目达产后出片量约为5W片/月，加上二期项目总出片量约8W片/月。该项目自2022年9月下旬起进入试生产阶段，试生产的产品良率符合预期，基本保持在95%以上。公司结合市场情况，目前该项目每月出片量约为6万片左右，在第三季度末尚未达到盈亏平衡，该项目仍处在产能爬坡期。目前，公司第四季度订单量保持上升势头。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应链的战略布局。

4、请问公司在南通的半导体6英寸项目是否已开始投产？

答：公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线”项目由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通科技产业园井冈山6号（捷捷半导体现有地块）。该项目计划采用深Trench刻蚀及填充工艺、高压等平面终端工艺，继续服务于公司晶闸管及二极管等业务。该项目主要是扩大现有防护器件的产能，由于产品的更新迭代，将来公司还会做一些更高端

的二极管，以及IGBT小信号的模块。该项目资金来源为捷捷半导体有限公司自有资金，原总投资为51,000万元人民币，因公司战略规划和经营发展需要，项目所需设施设备及其他费用的增加，公司对该项目进行增加投资，增加投资后的项目投资总额为80,930万元，土建投资19,000万元，设备投资52,300万元（包含18,000万元的机电安装费），铺底流动资金9,630万元。

（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：

【2023-008】）目前，该项目已于三季度投产，目前良率稳定，产能在爬坡阶段，达产后预计可形成6英寸晶圆100万片/年及100亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力。

5、公司可转债募投项目预计何时投产？预计每年能够完成多少产能的封测？

答：功率半导体“车规级”封测产业化项目主要从事车规级大功率器件的研发、生产及销售，本项目建设完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产品、120kk车规级大功率器件TOLL系列产品、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产品以及60kkWCSP电源器件产品的生产能力。项目达产后预计形成20亿的销售规模。目前项目进展：厂房已封顶，其他基础及配套正在建设中。原计划该项目达到预定可使用状态时间为2023年6月30日，但由于2022年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度明显下滑，市场消费类、工业类等应用领域需求端持续下降，加上国内外宏观经济环境等不确定性，导致公司项目建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，将本项目预计完成时间调整延期至2024年12月31日。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：【2023-070】）

6、请问公司在无锡新成立的IGBT团队目前进展如何？

答：公司控股子公司江苏易矽科技有限公司于2021年12月注册成立，注册资金2000万元，坐落于江苏省无锡市滨湖区国家集成电路设计中心。公司秉持“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细”的宗旨，致力于硅基IGBT及宽禁带等新型功率器件的设计研发，助力功率芯片国产化。江苏易矽由无锡芯路、捷捷微电及天津环鑫三方共同发起创建，该团队正按计划开展工作，正在进行650V和1200V两个电压平台的产品研发，部分型号已经实现小批量销售，具体型号请关注官网信息。6月份已有营收，至三季度末形成了近三百万左右的销售。应用领域包括变频家电、工业控制、光伏、储能、充电桩及新能源汽车等。由于高端产品认证周期长，后期会逐步延伸到光伏和汽车电子等高端领域，目前进展一切顺利。

7、公司目前MOSFET的业务模式是什么？

答：公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司部分产品的芯片委托芯片代工厂进行芯片制造，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除部分产品的芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。

8、贵司下游领域代表性的客户有哪些，未来重点的发展方向是什么？

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品的应用领域的不同，大致分为这几个类别：白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、光伏、电动工具和摩配等。根据国内销售统计，2023年前三季度工业类占销售额约42.9%，消费类占销售额约34.06%，汽车类占销售额约16.89%，通信类占销售额约3.49%，其他占销售额约2.65%。公司下游客户多并分散，应用领域宽泛，目前下游客户情况：低压电器领域主要有正泰、德力西等；家用电器领域主要有海信、美的等；防护应用领域主要有海康、大华股

份、飞利浦照明、威胜集团等；电动工具领域主要有得伟、天宁等；无功补偿、电子电力模块以及摩配领域也有众多优质客户。未来公司将重点拓展三大市场：汽车电子、电源类及工业类。在汽车电子领域：主要为各类马达驱动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动，锂电池管理，逆变器，压缩机等。

9、公司目前为应对半导体行业不景气，有什么预防措施？是否有考虑回购措施？

公司的晶闸管产品在半导体分立器件细分领域属于国内龙头，产品种类齐全、性价比高，产品的稳定性、一致性、可靠性高，完全可以替代国外同类产品。公司加强团队建设，完善各类激励机制，包括股权激励。未来公司将重点提升高端产品与重点市场应用推广，进一步提升产业创新与协同能力，保证产品结构符合产业结构发展趋势，夯实功率半导体进口替代能力，确保公司未来几年取得符合产业周期的较好增长。同时，我们将抓紧推进功率半导体“车规级”封测产业化项目和高端功率半导体产业化建设的推进，为未来5年打下一个比较好的基础。公司未来如有增持、回购等计划，将会严格按照信息披露规则履行信披义务，坚持真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作。

10、请问公司毛利率下降的主要原因是什么？

答：公司一直保持着较高的毛利率，2023年三季度报显示毛利率下降的主要原因是消费类市场仍较疲软还未恢复，由于受需求侧的影响价格波动较大，尤其是MOSFET，加上新项目处在产能爬坡期等。在目前的大环境影响下公司晶闸管等存量业务承受一定的压力，公司晶闸管的产线未能打满，单位成本上升。根据2022年芯谋研究的报告数据显示，在2022年全球各功率分立器件的营收及市场占比中，全球晶闸管市场份额仅占

2.5%，MOSFET市场占比仍然位居第一，占比40.7%。因此，公司在稳定现有存量业务的同时，持续研发投入逆势扩产，公司MOSFET业绩保证稳步提升。

由于受国内外经济因素等影响，目前功率半导体处在产业周期的较低区间，公司将继续深耕于功率半导体产业，紧紧围绕符合产业发展趋势IDM建模，加强公司治理与管理并重机制，稳健推进项目建设，积极推进团队建设，为公司产品矩阵和持续成长等蓄物、蓄力、蓄势，包括功率半导体器件赋能等。公司对高端功率半导体的进口替代及公司未来业绩持续稳步上升是有信心的。

11、公司三季报显示研发费用增长较大，请问公司未来研发费用在什么水平？

答：随着公司销售规模的提升和产品的不断丰富及换代升级等，立项的研发项目不断增加。公司持续增加研发投入，MOSFET收入占比提升显著，公司持续加强VDMOS、SJ MOS以及SGT MOS、先进TVS、先进整流器件等产品的研发工作。报告期末公司研发费用约1.83亿，较上年同期增加25.08%，约占三季度末营收的12.89%。未来，公司每年的研发费用保持在总销售额的7%以上，及研发投入成果转化率占营收比在20%以上。

12、请问公司三代半导体业务发展进展如何？

答：公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至2023年第三季度末，公司拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利5件，此外，公司还有6个发明专利尚在申请受理中。此外，公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。公司控股子公司江苏易矽科技有限公司也承担了一些碳化硅器件的研发任务。关于碳化硅器件和氮化镓器件，衬底材料决定了产品的成本在短期内很难降下来，此外还有产品良率等因素，决定了碳化硅、氮化镓器件目前只能适合高端应用。从产业化的视

	角，材料搞起才会有产业化进程的可能。据了解，商用领域短时间内产业化的可能性不大，需要长时间的沉淀和积累，长期来看或十年左右，这是功率半导体器件未来发展之必然。我们有耐心做好技术和人才的准备，后续进展情况，请继续关注公司的相关公告。
附件清单（如有）	无
日期	2023-10-30